华润微电子有限公司

投资者关系活动记录表

（2026 年 10 月）

证券简称：华润微 证券代码：688396

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☑业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	10 月 30 日 中信证券 申万宏源证券 中国国际金融股份 国泰海通证券 华泰证券 广发证券 兴业证券 光大证券 东方证券 中信建投证券 国金证券 国联民生证券 国海证券 山西证券 华西证券 浙商证券 德邦证券 华福证券 东吴证券 天风证券 长城证券 西部证券 开源证券 粤开证券 爱建证券 中银国际证券 易方达基金 广发基金 南方基金 嘉实基金 富国基金 汇添富基金 招商基金 鹏华基金 平安基金 睿远基金 华安基金 光大保德信基金 申万菱信基金 中银基金 银河基金 海富通基金 兴业基金 中信保诚基金 新华基金 国联基金 国联安基金 国金基金 长城基金 长信基金 金鹰基金 江信基金 安信基金 德邦基金

	华宝基金	上银基金	前海开源基金
	创金合信基金	圆信永丰基金	东方基金
	农银汇理基金	中航基金	中金基金
	信达澳亚基金	永赢基金	九泰基金
	华泰保兴基金	富安达基金	汇丰晋信基金
	恒昇基金	高毅资产	盘京投资
	理成资产	洛书投资	呈瑞投资
	珠池资产	恒穗资产	玖鹏资产
	非马投资	鑫垣私募	偕沣私募
	行知创投	巨杉资产	开煜股权投资基金
	榕树投资	伯利恒资产	前海夷吾资产
	星睿资产	尚诚资产	投控东海投资
	海创私募	润达私募	正圆私募
	行之私募	证国私募	江岳私募
	中海晟融资本	红思客资产	鸿远私募
	才华资本	北京鑫翰资本	中新融创资本
	青鼎资产	大筝资管	工银安盛资管
	世诚投资	瀚伦投资	宏恩资产
	铭朗投资	宝隽资产	国新投资
	红骅投资	狮城产业投资	中舍资产
	军璐投资	美阳投资	重庆渝汇投资
	瑞华投资	融捷投资	毅达股权投资基金
	平安养老保险	中邮人寿保险	太平养老
	太平资产	华泰资产	安联保险资管
	平安理财	建信理财	昆仑健康保险资管
	中航信托	华夏理财	浦银理财
	瑞银证券	摩根大通证券	渣打银行
	麦格理资本	野村国际证券	吕梁小金地资产
	施罗德投资	摩根士丹利基金	三井住友德思资管
	宏利资产	Bernstein	Ninety One
	Point72	XL Equities	METAPHASE FUND
	Triata Capital	SYNCICAP	ARTE Capital
时间	10 月 30 日		

地点	无锡
上市公司接待人员姓名	何小龙　华润微电子董事长 吴国屹　华润微电子董事、财务总监兼董秘
投资者关系活动主要内容介绍	**问题一：公司目前产能保持满载，如何看待四季度与明年一季度的需求趋势，以及本轮景气周期的持续性？** 答：目前公司在手订单可覆盖未来 6 个月以上的产出，部分热门产品待交付周期最高达 9 个月，晶圆产线保持满载运行，为四季度至明年一季度的经营提供了有力支撑。同时，公司持续优化订单和产品结构，将产能向高代次、高附加值产品倾斜，努力在保持收入规模的同时改善经营质量。 关于本轮景气周期，公司认为与过去主要由库存调整驱动的周期有所不同。AI 数据中心、新能源汽车、光储及工业电源等应用带来了较为明确的新增需求，机器人、无人机等也在逐步放量。与此同时，特色工艺产线从扩产、设备导入到客户认证和稳定量产需要较长周期，部分设备和原材料交期有所拉长，短期内有效供给难以快速增加。客户需求也在发生变化，除价格外，客户更加关注产品可靠性、交付稳定性和长期供应保障，这对具备 IDM 能力、丰富产品组合和制造平台的企业更为有利。 **问题二：今年行业陆续有价格调涨，公司的价格策略是什么？如何看待后续价格趋势？** 答：今年公司已分别发布两轮涨价函，三季度以来继续结合市场情况与部分客户沟通价格调整。公司的价格策略是分产品、分客户推进。 对于后续价格趋势，公司的判断是结构性支撑仍在：供需紧张、技术和可靠性要求较高的产品及工艺平台，价格支撑相对更强；标准化程度较高、竞争充分的消费类产品，仍可能面临价格压力。

	问题三：请问公司明年规划的产能口径是否有变化？ 答：今年 6 吋、8 吋已通过技术改造和瓶颈设备补充实现适度提升，明年预计以局部优化为主。重庆及深圳 12 吋项目计划利用现有洁净厂房，通过添置设备扩充产能，新增产能预计于明年下半年陆续释放。 **问题四：请问公司第三增长曲线光传感相关方向进展如何？预计何时开始贡献收入业绩？** 答：传感器及光芯片作为公司第三增长曲线，重点围绕光电传感、红外视觉、CIS 和 MEMS 等方向布局，面向光通信、机器人、智能驾驶和边缘计算等应用。其中，传感器已有一定营收体量，光芯片整体处于技术布局和项目储备阶段。 **问题五：请问公司产品在机器人领域的布局情况，当前客户需求、业务导入及合作进展？** 答：公司将机器人作为新兴领域的重要方向，围绕电池管理、配电管理及关节模组控制等场景，布局 MOSFET、PMIC、MCU、驱动及传感器等产品，推动由单一器件向多产品组合方案升级。公司机器人领域收入同比实现较快增长，但业务体量及基数较小，行业整体仍处于起步阶段。公司已与多家整机及关节模组客户开展合作，部分项目实现导入和上量，并储备了一批潜在客户。 **问题六：请问公司碳化硅产品毛利率水平及盈利能力？未来产能布局如何？** 答：公司碳化硅产品毛利率已于去年整体转正，但受前期价格下行、规模效应和产品结构影响，整体仍低于硅基产品。不同应用之间差异较大，新兴应用领域毛利率较高、工业能源类相对稳健，

	汽车类产品目前相对较低。公司仍在持续推动新老代次切换、良率提升及规模效应释放，SiC 业务盈利能力有望继续改善。 目前 SiC 产能处于供不应求状态，公司积极寻找外协产能，与外部供应商深度合作，并通过投资并购、参股等方式锁定产能，保障订单交付，相较自建更为灵活高效。 **问题七：请问公司如何看待客户的库存水平？** 答：从公司掌握的情况看，不同领域、不同规模的客户库存水平有一定差异，整体处于正常且可消化的水平。今年以来，公司订单和交付始终处于偏紧的状态，现有产能和交付能力尚不能完全满足订单需求，部分热门产品仍存在交付缺口。为缓解交付压力，公司也在积极调配外部晶圆代工和封装资源作为补充，努力缩短订单交付周期。同时，公司也会根据订单紧迫程度和客户需求动态安排生产与交付，避免短期供应紧张引发过度备货。 **问题八：请问公司 PLP 先进封装的技术及业务进展如何？** 答：公司 PLP 业务已形成双面互连、多层高密度布线和 SiP 集成三大产业化平台，重点应用包括光模块、汽车电子和无线充电等领域。经过多年客户培育，目前订单持续增长，产能供不应求，新品导入明显加快，三季度以来月收入连创新高。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 10 月